

HB30 粗引线键合机

产品名称	HB30 粗引线键合机
公司名称	北京锐峰先科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPT 型号:HB30
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦4015室
联系电话	13911457960

产品详情

TPT Wire Bonder

HB30 粗引线键合机

马达驱动Z&Y轴

+ 100 μ m至500 μ m铝线

+ 6.5 ” 液晶触摸屏

+ 100个程序的存储能力

+ 内置双光纤照明灯

+ 马达驱动Z轴键合头

+ 马达驱动Y轴用于后退弧度控制

+ X-Y机构比例为6:1

+ 线弧可编辑

+ 可进行缝焊

+ 半自动，分步和手动键合模式

HB30 粗引线键合机

HB30是一台桌上型键合机，是实验室、试点或预生产试运行、或小批量生产线的理想设备用触摸屏容易操作。所有键合参数可以直接进入并进行简单的调节。

技术规格

超声系统 PLL US系统

超声功率 50 W输出

键合时间 0 - 10 秒

键合力 50 - 1500 cN

铝线直径 100 - 500 μ m

断线 前面切断

送线角度 90度

马达驱动Y轴行程 后退高达17mm

马达驱动Z轴行程 20mm

微调平台移动 15mm

机构比 6:1 (3:1可选)

电力需求 100-240V +/-10% , 50/60Hz , 最大10A

外形尺寸 680x640x490mm

重量 净重50kg